

半导体展6月26日举办-展位火热预定中

产品名称	半导体展6月26日举办-展位火热预定中
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日 展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

展出面积场 60,000 平方米，参展企业800+家，参观观众60,000 人，主题活动 40+场。

2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会（展会简称：SEMI-e）是由中国通信工业协会、深圳市半导体行业协会、深圳市中新材会展有限公司、江苏省半导体行业协会、浙江省半导体行业协会、成都市集成电路行业协会等单位联合主办。

展会亮点

年度行业盛会 作为华南区具影响力的半导体展，本届展会预计将吸引超过800余家企业 参展，集中展示集成电路、电子元器件、第三代半导体及产业链材料和设备 为一体的半导体产业链。展会为企业达成贸易合作和市场开发双向赋能，加强生产研发销售三端互动，为参会企业和观众深入洞悉半导体市场未来发展新风向提供全方位的服务和参考。

百家媒体宣传报道 SEMI-e注重对展商企业品牌的塑造和推广，在消费类电子、智能制造、物联网、汽车电子、手机、数码产品、LED照明、集成电路、5G+、半导体等领域的全媒体矩阵将在展前、展中以及展后进行持续的全方位、多角度、立体化的跟踪宣传报道。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

- 3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等
- 4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等
- 5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等
- 6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等
- 7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等
- 8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等
- 9：电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等
- 10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等汽车雷达传感器上下游供应链各环节产品等
- 11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等
- 12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等
- 13、汽车半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、汽车电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

第六届SEMI-e以【“芯”中有“算”·智享未来】为主题，60,000平方米展出面积，800余家展商，预计观众人数达60,000+。本届展会展示以芯片设计及制造、半导体制造、封测、材料和设备、零部件及检测外，突出AI算力、算法、存储、工业控制、汽车智能化、物联网、AI医疗、教育、智慧能源控制等各种新应用解决方案。

2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

期待您的莅临！